



2022年7月20日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 I R 室 長 野 田 耕 一  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

## パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社における設備投資（新工場建設）に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の当社取締役会で、パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社である江蘇富楽華半導体科技股份有限公司（以下、「FTSJ」）において新工場建設を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 投資の背景等

- ・当社パワー半導体事業は急速な拡大を遂げており、現状の生産拠点である上海及び東台の工場は用地面でもこれ以上の拡大余地がないため、パワー半導体基板の第三工場建設の検討の結果、当社事業拠点もあり、かつ需要地である中国西部の自動車関連産業集中地域への交通の便も良い四川省内江市で新工場に適した用地確保を致したうえで新工場建設の計画を進めてまいりました。この新工場建設により、成長著しいパワー半導体市場の需要を取り込み事業拡大に注力致します。
- ・また、新工場設立に際し、FTSJ子会社である四川富楽華半導体科技有限公司を設立致しました。本工場の管理・運営を行ってまいります。
- ・なお、過去の適時開示経過を<ご参考>「Appendix. I FTSJに関する既往開示内容一覧」に記載しておりますのであわせてご参照ください。

#### 2. 設備投資の概要

(1)	投 資 金 額	832,695 千中国元（約 171 億円）※1 中国元=20.51 円 →本件は一期（2023 年）投資分 二期（2025 年）投資は直近状況に応じて申請
(2)	新 工 場 建 設 地	中国四川省内江市内江経済技術開発区内
(3)	一 期 投 資 の 内 容	工場建屋等：368,400 千中国元（約 76 億円）※1 中国元=20.51 円 (建屋総床面積：約 80,000 m <sup>2</sup> ) 機械・設備：464,295 千中国元（約 95 億円)
(4)	一 期 スケジュール	・建設工事着工：2022 年 7 月 ・建屋等完成：2023 年 6 月 ・機械設備設置：2023 年 12 月
(5)	操 業 開 始 予 定	2024 年 1 月

### 3. 子会社の概要

#### 1) FTSJ の概要 (2022年6月30日現在)

(1)	名 称	江蘇富樂華半導体科技股份有限公司 (FTSJ)	
(2)	所 在 地	中国江蘇省東台市城東新区鴻達路 18 号	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売	
(5)	資 本 金	379,158 千中国元 (約 78 億円) ※ 1 中国元=20.51 円	
(6)	設 立 年 月 日	2018 年 3 月 16 日	
(7)	大株主及び持ち分比率	株主名 上海申和投資有限公司 (略称 FTS)	持ち分比率 60.6%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社である FTS が議決権の 60.6%を保有する子会社
		人 的 関 係	当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

#### 2) 四川富樂華半導体科技有限公司の概要 (2022年6月30日現在)

(1)	名 称	四川富樂華半導体科技有限公司	
(2)	所 在 地	中国四川省内江市内江經濟技術開發区漢晨路 888 号 8 幢	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売	
(5)	資 本 金	30,000 千中国元 (約 6 億円) ※ 1 中国元=20.51 円	
(6)	設 立 年 月 日	2022 年 4 月 20 日	
(7)	大株主及び持ち分比率	株主名 江蘇富樂華半導体科技股份有限公司 (FTSJ)	持ち分比率 100%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社である FTS が議決権の 60.6%を保有する子会社の 100%子会社
		人 的 関 係	当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

### 4. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

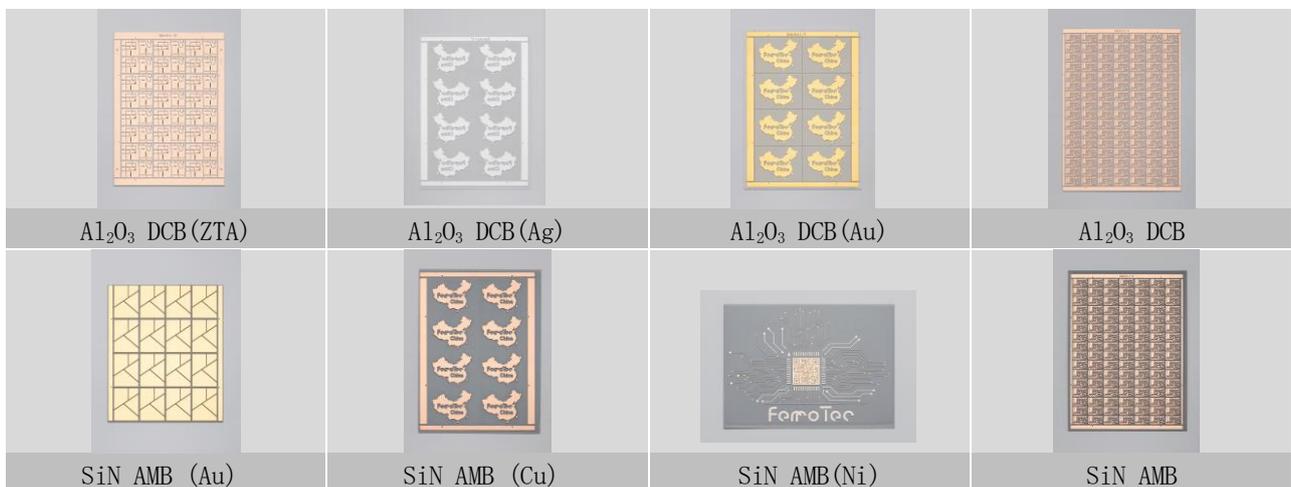
以 上

<ご参考>

Appendix. I FTSJ に関する既往開示内容一覧

開示日	表題
2022/5/27	「(開示事項の変更・訂正)パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第四回)」
2022/3/17	「(開示事項の訂正)パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」
2022/3/16	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第四回)」
2022/3/7	「半導体用絶縁放熱基板製造子会社における投資契約締結のお知らせ」
2022/2/25	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による華泰連合証券との上場に関するアドバイザー契約の締結、および 中国証券監督管理委員会による登録のお知らせ」
2021/8/6	「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」
2021/4/28	「(開示事項の変更)パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」
2021/4/15	「パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」
2021/3/19	「(開示事項の追加・訂正)パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ(第二弾)」
2021/2/10	「パワー半導体基板子会社の第三者割当増資に関するお知らせ(第二弾)」
2020/11/17	「パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」

Appendix. II FTSJ 取り扱いパワー半導体用絶縁放熱基板製品 (一部)



Appendix. III パワー半導体の種類と耐圧・用途

DCB/AMB 主な市場範囲：産業機器、自動車、電気鉄道、再生可能エネルギー

